

北京君正集成电路股份有限公司

关于重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“公司”）及/或其全资子公司合肥君正拟以发行股份及/或支付现金的方式购买北京矽成半导体有限公司 59.99%股权及上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）100%财产份额（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，其中上市公司控股股东、实际控制人之一刘强或其控制的关联方将认购不低于配套资金的 50%（以下合称为“本次重组”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

在本次重组前 12 个月内，公司发生资产交易情况如下：

2018 年 4 月，公司与深圳吉迪思电子科技有限公司（以下简称“吉迪思”）共同签署了《北京君正集成电路股份有限公司与田琪及深圳吉迪思电子科技有限公司关于深圳吉迪思电子科技有限公司之增资协议》，以自有资金向吉迪思投资人民币 1,000 万元，投资完成后，持有其 5.8824%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资可由董事长作出决策，无需提交公司董事会和股东大会审议。公司已于 2018 年 5 月完成上述出资，并于 2018 年 6 月完成工商变更。

吉迪思主要从事智能设备显示主控芯片的设计、研发及相关电子产品的销售。北京矽成主要从事集成电路存储芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。

除上述情形外，本次重组前 12 个月内公司未发生其他资产购买及出售情况。特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司关于重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）

北京君正集成电路股份有限公司

2019 年 5 月 16 日